

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 4 区分

【発行日】平成30年6月28日 (2018.6.28)

【公表番号】特表2017-518599(P2017-518599A)

【公表日】平成29年7月6日 (2017.7.6)

【年通号数】公開・登録公報2017-025

【出願番号】特願2016-561295(P2016-561295)

【国際特許分類】

G 1 1 B 5/48 (2006.01)

G 1 1 B 21/16 (2006.01)

G 1 1 B 21/21 (2006.01)

【F I】

G 1 1 B 5/48 D

G 1 1 B 21/16 Z

G 1 1 B 21/21 C

【手続補正書】

【提出日】平成30年5月15日 (2018.5.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ハードディスクドライブ用のスエージマウントであって、
 基材と、
 被覆材料と、前記被覆材料を通して拡散された導電材料との混合物であって、前記基材の予め定められた部分を覆う混合物と、を備え、
 前記被覆材料が前記基材の他の部分を覆う、
 スエージマウント。

【請求項 2】

前記導電材料は、金、白金、ロジウム、スズ、及び銀から成る群のうちの 1 つ、又は、前記群のうちの 1 つの合金である、請求項 1 に記載のスエージマウント。

【請求項 3】

前記導電材料が 8 % 以上且つ 14 % 以下の割合の金である、請求項 1 に記載のスエージマウント。

【請求項 4】

前記被覆材料は、ニッケル、スルファミン酸ニッケル、及びパラジウムから成る群、又は、前記群のうちの 1 つの合金から選択される、請求項 1 に記載のスエージマウント。

【請求項 5】

前記被覆材料が前記基材上にメッキされたニッケルである、請求項 1 に記載のスエージマウント。

【請求項 6】

前記基材がステンレス鋼である、請求項 1 に記載のスエージマウント。

【請求項 7】

更に、
 本体部分を有するフランジ部分と、先端部分であって、前記本体部分から延在する柄部分と、前記本体部分の遠位の横棒部分とを含む先端部分と、前記本体部分の開口を取り囲

むハブと、を備え、

導電性の混合物が、前記柄部分と、前記ハブと前記柄部分との間における前記本体部分の領域とを覆う、請求項 1 に記載のスエージマウント。

【請求項 8】

更に、

本体部分を有するフランジ部分と、先端部分であって、前記本体部分から延在する柄部分と、前記本体部分の遠位の横棒部分とを含む先端部分と、前記本体部分の開口を取り囲むハブと、を備え、

導電性の混合物が、前記横棒部分の少なくとも一部を覆う、請求項 1 に記載のスエージマウント。

【請求項 9】

ハードディスクドライブ用のスエージマウントを製造する方法であって、

前記スエージマウントの予め定められた部分上に導電材料を堆積することと、

前記予め定められた部分を含む前記スエージマウント上に被覆材料を堆積することと、

前記スエージマウントに熱を加えて、前記導電材料と前記被覆材料との混合物を形成することと、

を含む、方法。

【請求項 10】

更に、

基材からスエージマウントを型打ちすることを含み、前記被覆材料を堆積することは、前記型打ちされたスエージマウント上で行われる、請求項 9 に記載の方法。

【請求項 11】

基材からハードディスクドライブ用のスエージマウントを製造する方法であって、

前記基材の予め定められた部分上に導電材料を堆積することと、

前記堆積された基材からスエージマウントを型打ちすることと、

前記予め定められた部分を含む前記スエージマウント上に被覆材料を堆積することと、

前記スエージマウントに熱を加えて、前記導電材料と前記被覆材料との混合物を形成することと、

を含む、方法。

【請求項 12】

更に、

前記型打ちされたスエージマウントをバリ取りすることを含み、前記被覆材料を堆積することは、前記バリ取りされたスエージマウント上で行われる、請求項 11 に記載の方法。

【請求項 13】

基材からハードディスクドライブ用のスエージマウントを製造する方法であって、

前記基材の予め定められた部分上に導電材料を堆積することと、

前記予め定められた部分を含む前記基材上に被覆材料を堆積することと、

前記堆積された基材からスエージマウントを型打ちすることと、

前記スエージマウントに熱を加えて、前記導電材料と前記被覆材料との混合物を形成することと、

を含む、方法。

【請求項 14】

基材からハードディスクドライブ用のスエージマウントを製造する方法であって、

前記基材の予め定められた部分上に導電材料を堆積することと、

前記予め定められた部分を含む前記基材上に被覆材料を堆積することと、

前記基材に熱を加えて、前記導電材料と前記被覆材料との混合物を形成することと、

前記堆積され且つ熱を加えられた基材からスエージマウントを型打ちすることと、

を含む、方法。